

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載  
 【部門区分】第2部門第4区分  
 【発行日】平成30年2月8日(2018.2.8)

【公開番号】特開2016-83925(P2016-83925A)  
 【公開日】平成28年5月19日(2016.5.19)  
 【年通号数】公開・登録公報2016-030  
 【出願番号】特願2015-103636(P2015-103636)  
 【国際特許分類】

**B 3 2 B 17/10 (2006.01)**  
**H 0 1 L 51/50 (2006.01)**  
**H 0 5 B 33/02 (2006.01)**  
**H 0 1 L 21/02 (2006.01)**  
**H 0 1 L 27/12 (2006.01)**  
**G 0 9 F 9/00 (2006.01)**  
**G 0 9 F 9/30 (2006.01)**  
**H 0 1 L 31/0392 (2006.01)**

【F I】

B 3 2 B 17/10  
 H 0 5 B 33/14 A  
 H 0 5 B 33/02  
 H 0 1 L 27/12 B  
 G 0 9 F 9/00 3 4 2  
 G 0 9 F 9/30 3 1 0  
 H 0 1 L 31/04 2 8 4

【手続補正書】  
 【提出日】平成29年12月19日(2017.12.19)

【手続補正1】  
 【補正対象書類名】特許請求の範囲  
 【補正対象項目名】全文  
 【補正方法】変更  
 【補正の内容】  
 【特許請求の範囲】

【請求項1】

厚み0.2mm以上、5mm以下の支持板、引張弾性率が50MPa以上、2500MPa以下、引張破断強度が10MPa以上、且つ、引張破断伸度が5%以上の硬化樹脂層、及び厚み200μm以下のガラス基板をこの順に備え、

ガラス基板の厚み(d1)と硬化樹脂層の厚み(d2)との比(d1/d2)が0.3~3、且つ、ガラス基板と硬化樹脂層の総厚(d1+d2)と支持板の厚み(d3)との比(d3/(d1+d2))が1~2.5であり、且つ、

支持板と硬化樹脂層の界面の剥離強度が、硬化樹脂層とガラス基板の界面の剥離強度よりも低い、ガラス積層体。

【請求項2】

前記支持板の硬化樹脂層側表面が、離型処理されていることを特徴とする請求項1に記載のガラス積層体。

【請求項3】

前記硬化樹脂層の引張破断伸度が10%以上であることを特徴とする請求項1又は2に記載のガラス積層体。

【請求項4】

前記ガラス基板が、前記硬化樹脂層の外形の内側に設けられていることを特徴とする請求項 1 ~ 3 いずれか 1 項に記載のガラス積層体。

【請求項 5】

前記硬化樹脂層が、紫外線硬化性組成物からなる層を硬化させて得られる層であることを特徴とする、請求項 1 ~ 4 のいずれか 1 項に記載のガラス積層体。

【請求項 6】

請求項 1 ~ 5 のいずれか 1 項に記載のガラス積層体から、支持板を硬化樹脂層と支持板との界面で剥離して得られる電子デバイス用基板。

【請求項 7】

請求項 6 に記載の電子デバイス用基板を用いてなる電子デバイス。

【請求項 8】

請求項 1 ~ 5 のいずれか 1 項に記載のガラス積層体を製造する方法であって、硬化性組成物、ガラス基板、及び支持板を積層した後、硬化性組成物からなる層を硬化させて硬化樹脂層を形成する工程、を含む製造方法。